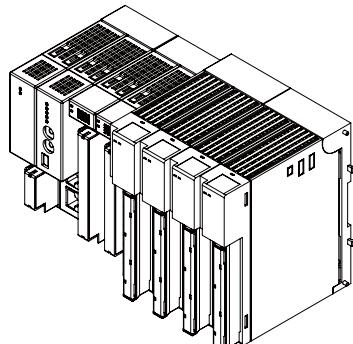


## 遠端 I/O R30 系列

## 安裝基座 (增設 R3 輸出入模組用)



## 注意事項

• 安裝在 R30EBS 上的 R3 系列 I/O 模組的內部匯流排通信週期如下:

內部匯流排通信週期 =  $6\text{ ms} \times \text{I/O 模組數量} + 10\text{ ms}$  (主CPU 資料更新周期)

例: 4 個 R3 I/O 模組

$6\text{ ms} \times 4 + 10\text{ ms} = 34\text{ ms}$

即使將 R30EBS 增設連接到 R30BS, R30 系列的匯流排通信週期也將保持在大約 1 ms。

## 一般規格

## 可安裝模組台數:

R30EBS04: I/O 模組, 4 台

R30EBS08: I/O 模組, 8 台

## 安裝規格

工作溫度:  $-10 \sim +55^\circ\text{C}$  ( $14 \sim 131^\circ\text{F}$ )

保存溫度:  $-20 \sim +65^\circ\text{C}$  ( $-4 \sim 149^\circ\text{F}$ )

工作濕度: 10 ~ 90 %RH (無結露)

使用周圍環境: 無腐蝕性氣體及嚴重粉塵

安裝: 壁掛或DIN滑軌

重量 (沒有安裝模組時)

R30EBS04: 約 150 g (0.33 lb)

R30EBS08: 約 280 g (0.62 lb)

## 性能

耐電壓: 1500 V AC @1 分鐘

(內部電源或內部通信匯流排- FE 之間;

在電源模組上隔離)

## 型號: R30EBS[1][2]

## 訂購時指定事項

• 代碼: R30EBS[1][2]

參考下面 [1] 到 [2] 說明並指定各項代碼。

(例如: R30EBS08/Q)

• 指定選項代碼/Q 的規格

(例如: /C01)

## [1] I/O 槍位數量

04: 4 槍

08: 8 槍

## [2] 選項

空白: 無

/Q: 有選項 (需指定選項規格)

## 選項規格 : Q

塗層 (有關詳細訊息, 請參考 M-System 的網站。)

只有基板的焊接面有塗層。

模組安裝面沒有塗層。

/C01: 砂膠塗層

/C02: 聚氨酯塗層

/C03: 橡膠塗層

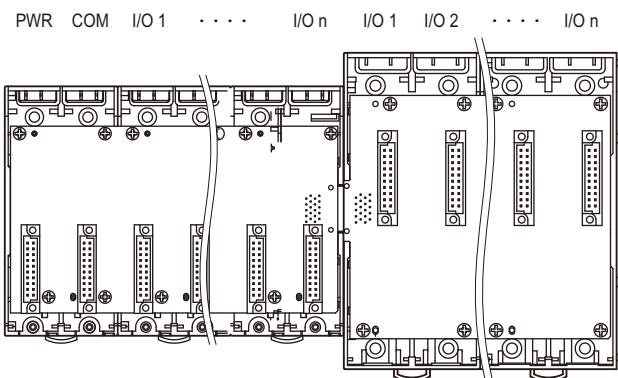
## 主要機能及特點

將 R3 系列 I/O 模組增加到 R30 系列模組使用時的安裝基座。

將此基座連接到 R30BS 進行擴充。R3 系列 I/O 模組可使用的種類和數量受到電源模組和網路模組的限制。請參閱每個模組的規格書和使用說明書。

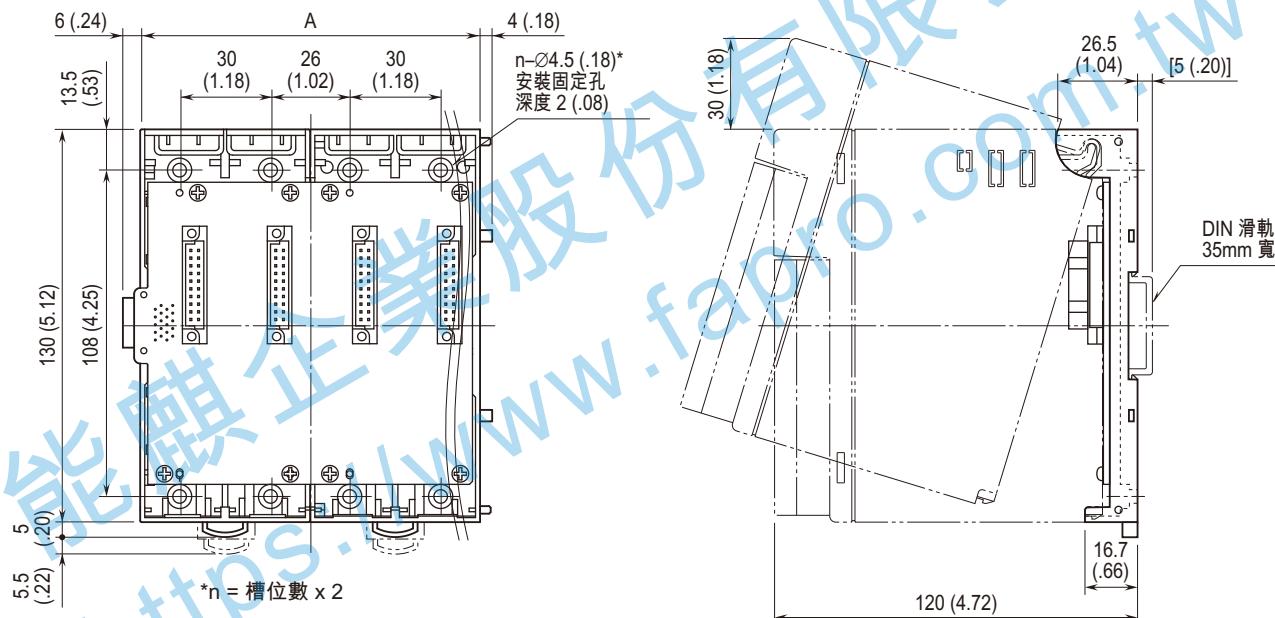
## 外部視圖

與 R30BS 組合使用。請從最左端 (I/O 1) 向右安裝 R3 I/O 模組。



外型尺寸圖 單位: mm [inch]

## ■ R30EBS04, 08

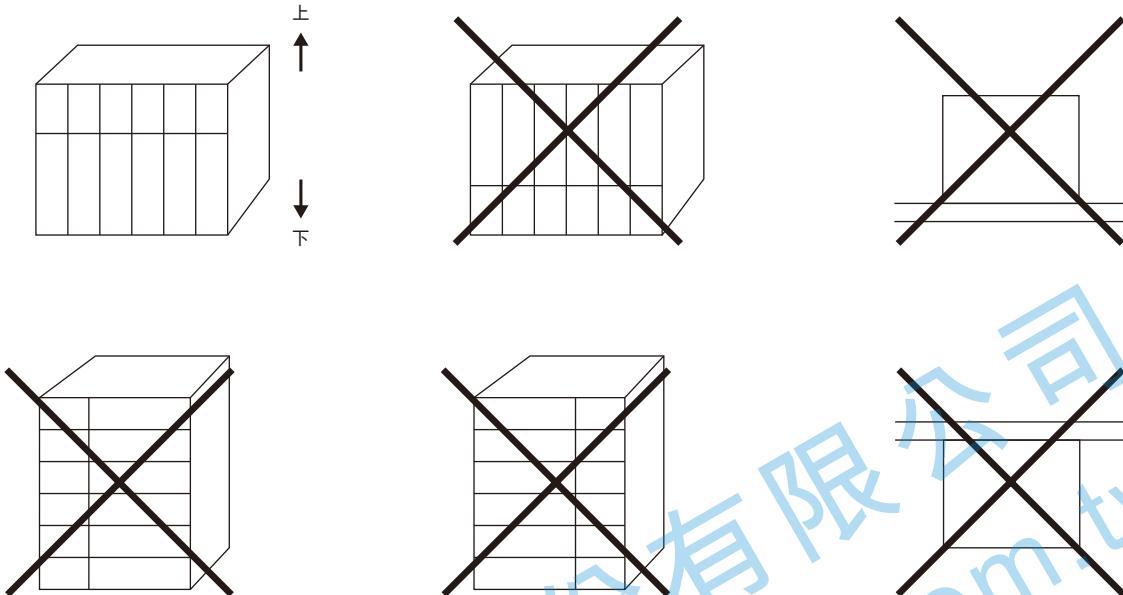


型號	A (尺寸)	(安裝螺釘數量 n)
R30EBS04	112	8
R30EBS08	224	16

## 安裝尺寸圖 單位: mm [inch]

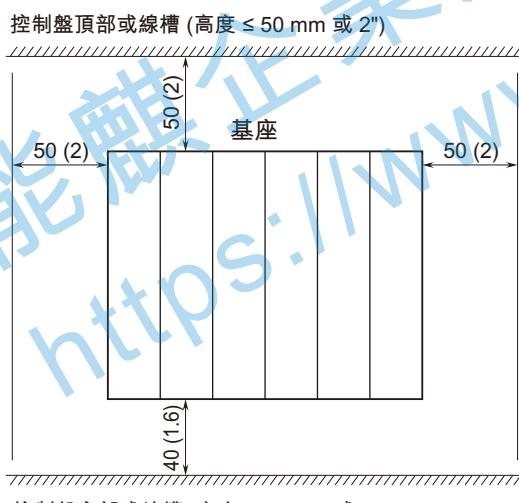
## ■ 安裝方向

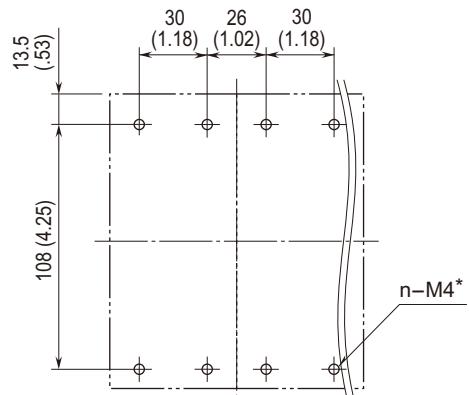
請依下圖所示垂直安裝。若以其它方向安裝可能會導致模組內部溫度上升，從而縮短使用壽命或降低性能。



## ■ 安裝在控制盤內

請確保有足夠的通風空間。請勿將裝置安裝在可能產生大量輻射熱的設備上方，例如加熱器、變壓器或電阻器。設備上方和下方也需要保留維護用空間。





\*n = 槽位數 x 2



規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司  
<https://www.fapro.com.tw>